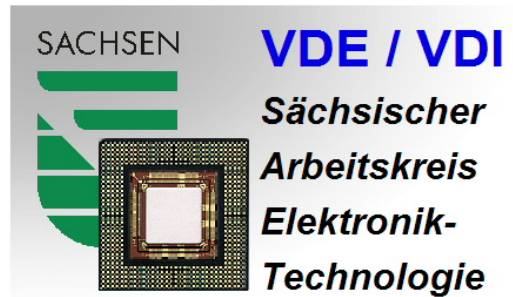


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)
01069 Dresden
e-mail: bauer@et.htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann, TU Dresden
e-mail: oppermann@zmp.et.tu-dresden.de

Dipl.-Ing. Dietmar Daniel, HTW Dresden (FH)
e-mail: daniel@et.htw-dresden.de



Informationen zum Arbeitskreis im Internet:

<http://www.avt.et.tu-dresden.de/SAET/>

54. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

Datum: Mittwoch, 30. Juni 2010 12:30 Uhr - 17:00 Uhr

Thema: Materialien für die Elektronik-Technologie

**Gastgeber: Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS)
Winterbergstraße 28, 01277 Dresden**

Leitung: Herr Prof.Dr.-Ing. Reinhard Bauer,
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fachbereich Elektrotechnik

Agenda:

- 12:30 Begrüßung und Vorstellung IKTS
- 13:00 Frau Dr. Feller (IKTS): Elektrochemische Sensoren in Dickschichttechnik
- 13:30 Frau Dr. Mosch und Herr Dr. Fritsch (IKTS): Finelinestrukturierung von Dickschichtpasten

- 14:00 Kaffeepause

- 14:15 Herr Dr. Herenz (Fa. Hella KG): Aktueller Status und Problemstellung der Bleifreieinführung im KFZ
- 14:45 Herr Dr. Heuer (Fraunhofer IZFP-D): Wirbelstrombasierte Methoden zur Prüfung von Schichtsystemen und Kontaktstrukturen in der Solarzellenproduktion
- 15:15 Herr Kemenas (Fa. WENO Maschinenbau GmbH): Neue mikroskopische Inline-Inspektion am Beispiel von Dickschichtschaltungen und Solarzellen

- 15:45 Abschlussdiskussion

- 16:00 Laborführung

- Ende gegen 17:00 Uhr.